

Instructivo de Desensamble al Final de la Vida Útil

Propósito: Este documento está confeccionado para ser utilizado por recicladores o instalaciones de reciclaje al final de la vida útil del producto. Provee instrucciones básicas para el desensamble de productos MSP TECH para la remoción de componentes y materiales que requieren tratamiento selectivo, como está definido en la Directiva de la Unión Europea 2012/19/UE, *Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*.



Categoría de producto: Desktop

Modelos: MSP Tech MSPA21SG23I-02, MSP Tech MSPA21H570I-02, MSP Tech MSPA21H470-02

Ítems que requieren tratamiento selectivo

Componente	Observación	Cantidad
Tabletas de Circuito Impreso (PCB) o Montaje de Circuito Impreso (PCA)	Con una superficie mayor a 10 cm ²	8
Baterías	De todo tipo	1
Componentes conteniendo mercurio	Por ejemplo, mercurio en lámparas	0
Pantalla de Cristal Líquido (LCD)	Con superficie mayor a 100 cm ²	0
Tubos de rayos catódicos		0
Capacitores/condensadores (contenidos en los PCB/PCA)	Condensadores/capacitores que contengan policlorobifenilos (PCB)	0
Capacitores electrolíticos/Condensadores mayores a 2.5cm en diámetro o en altura	Condensadores/capacitores que contengan policlorobifenilos (PCB)	0
Cables externos eléctricos		1
Lámparas de gas descargable		0
Plásticos conteniendo pirorretardantes bromados		0
Componentes o partes que contengan tóner o tinta, incluyendo líquidos, semi-líquidos (gel/pasta) y toner	Incluye cartuchos, tubos, cámaras	0
Componentes y partes que contengan amianto		0
Componentes, partes y materiales que contienen fibras cerámicas refractarias		0
Componentes, partes y materiales que contienen sustancias radiactivas		0
Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC)		0

Herramientas requeridas

Herramientas	Imágenes
Destornillador "Phillips" punta cruz (requerido)	
Herramienta de metal tipo espátula (opcional)	

Ubicación de las partes que requieren tratamiento selectivo

Componente	Cantidad	Ubicación y/o detalle
Tabletas de Circuito Impreso (PCB) o Montaje de Circuito Impreso (PCA) con una superficie mayor a 10 cm ²	8	Ubicados en: <ul style="list-style-type: none">• Placa madre• Placa del disco duro• Procesador• Fuente de poder• Tarjeta de video• Tarjeta de red• Tarjeta wifi• Memoria RAM
Baterías	1	Una batería de litio ubicada en el procesador
Cables externos eléctricos	1	Cable de poder que viene con el producto

Proceso de desensamble

1. Colocar la CPU en posición horizontal sobre una superficie plana.



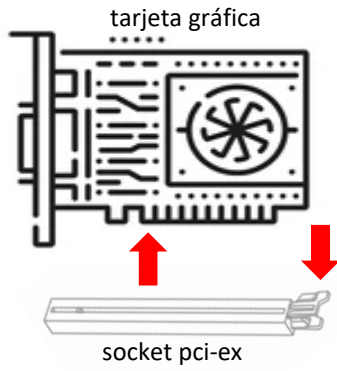
2. Destornillar los 2 (dos) tornillos



3. Presionar con un dedo y deslizar hacia la parte trasera del chasis utilizando la oreja metálica.



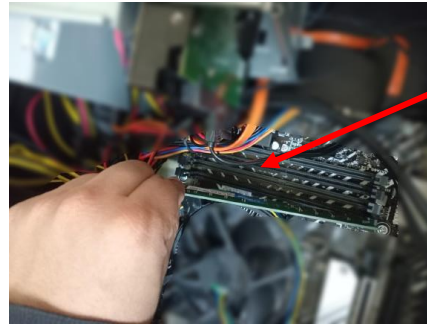
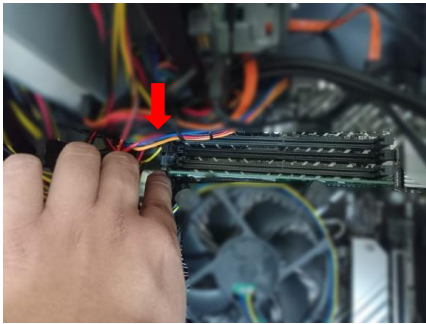
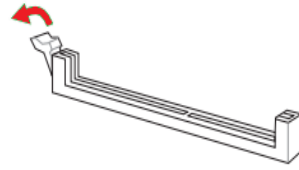
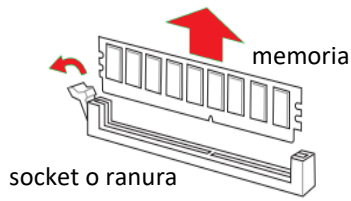
4. Extracción de la tarjeta de video: Presione la pestaña del socket pci-ex para liberar la tarjeta de video y luego extraerla manualmente estirando hacia arriba.



Tableta de
Circuito

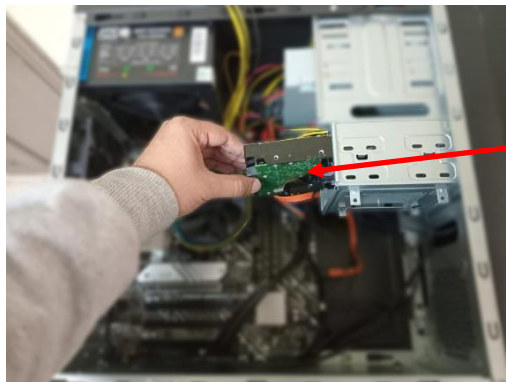
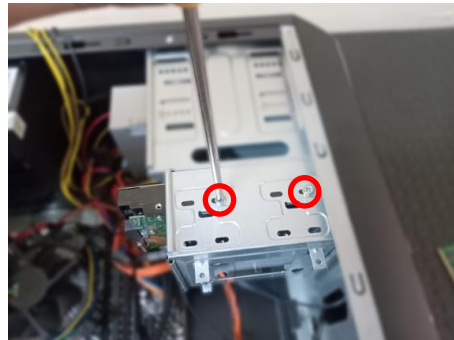
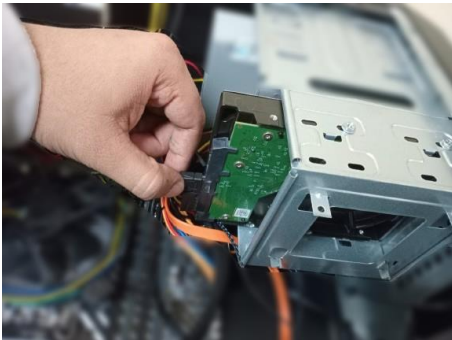


5. Extracción de la memoria RAM: Presionar la pestaña ubicada en el extremo del socket de la memoria y extraerla manualmente.



Tableta de
Circuito
Impreso

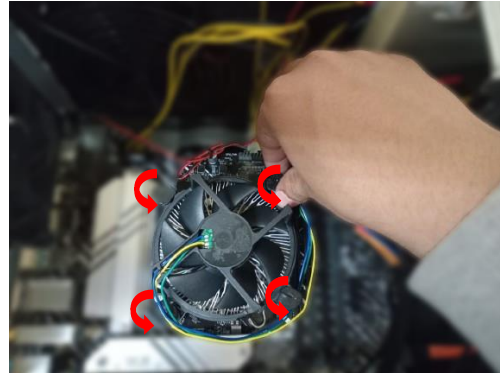
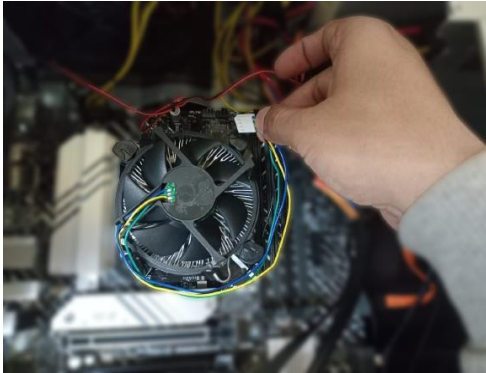
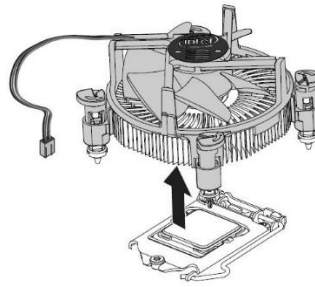
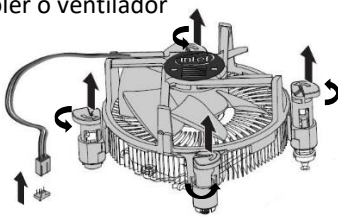
6. Extracción del disco duro: Desconectar los cables sata datos y sata fuente y luego quitar tornillos que lo sujetan al chasis.



Tableta de
Circuito
Impreso por
el disco
duro

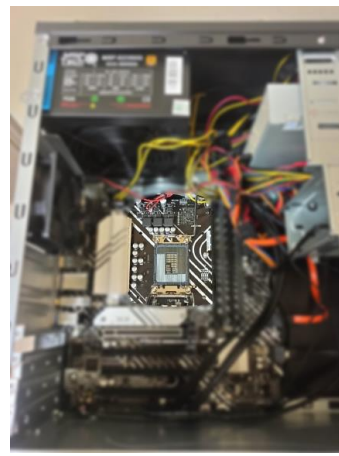
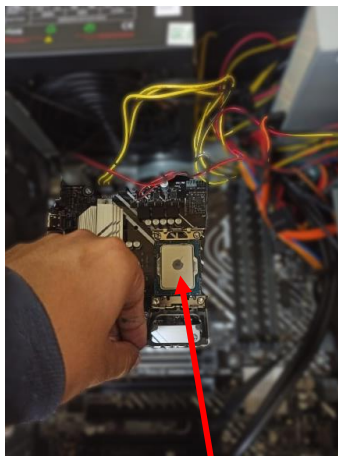
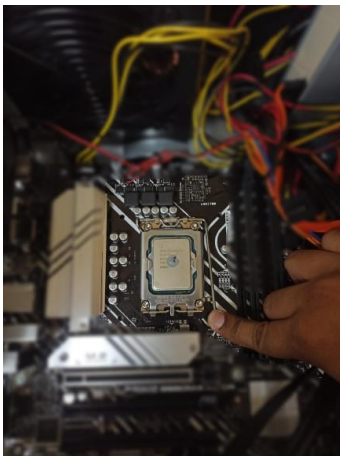
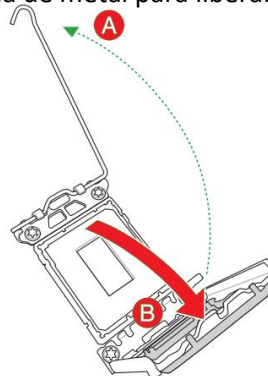
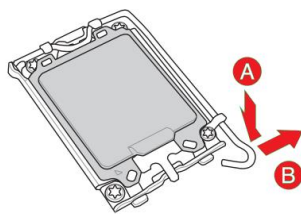
7. Extracción del ventilador del procesador: Desconecte el cable, gire y levante las 4 (cuatro) pestañas o seguros del ventilador, luego retíralo manualmente.

Cooler o ventilador



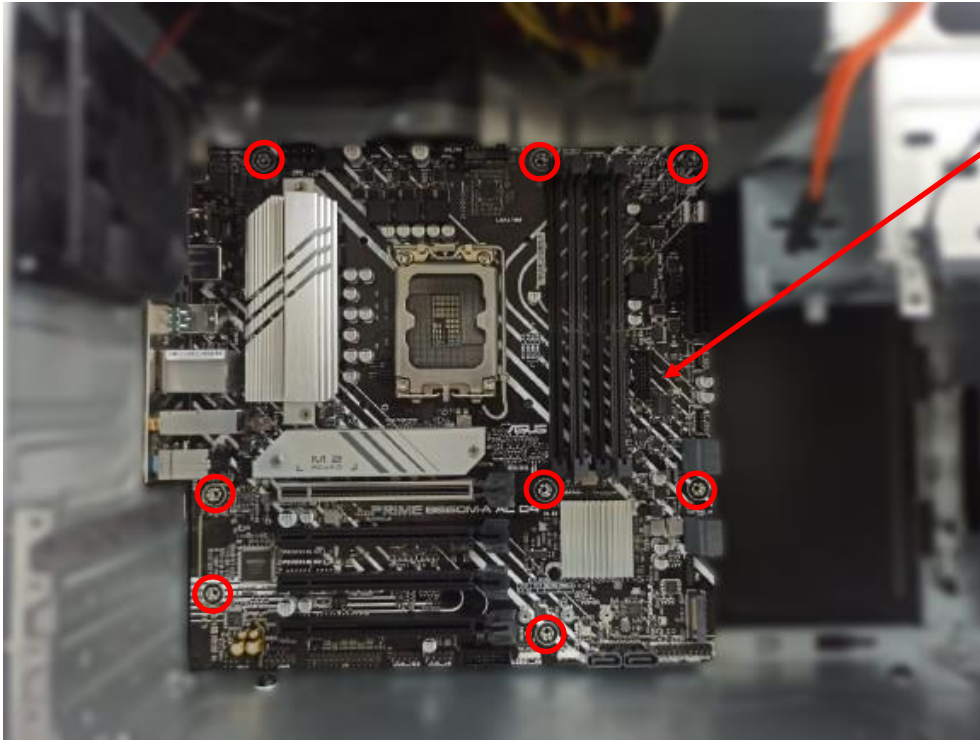
8. Extracción del procesador: Presionar la varilla de metal para liberar el procesador, luego retire el procesador manualmente.

Socket del procesador

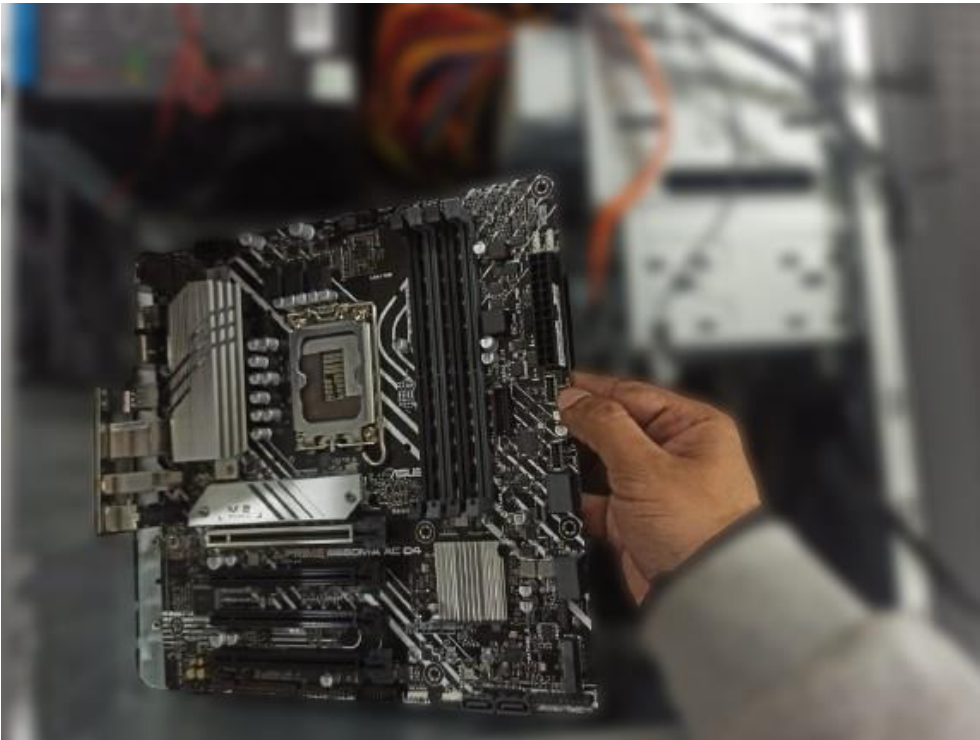


Tableta de
Circuito
Impreso

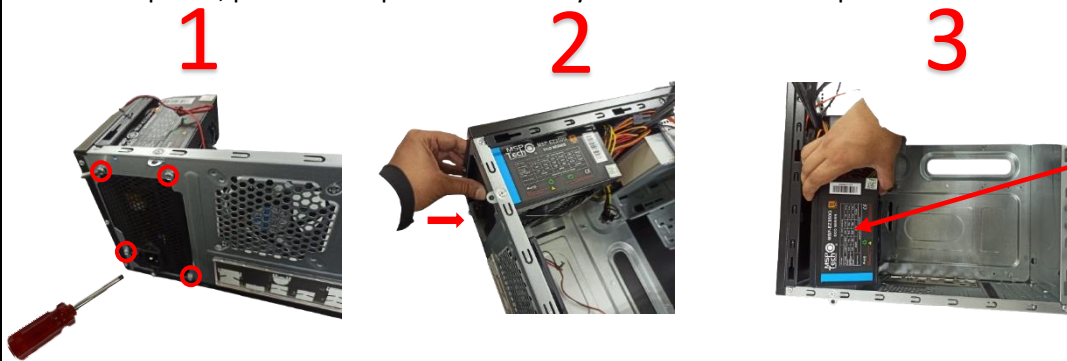
9. Extracción de la placa madre: Destornillar los tornillos que sujetan a la placa madre al chasis y retirar manualmente.



Tableta de
Circuito
Impreso



10. Extracción de la fuente de poder: Destornillar los 4 tornillos exteriores de la fuente de poder, presionar la pestaña interna y extraer la fuente de poder manualmente.



Dentro de la Fuente de Poder se encuentra una tarjeta de circuito impreso.

11. Extracción de la careta frontal: estirar la careta con fuerza moderada para liberar del seguro y luego remover.



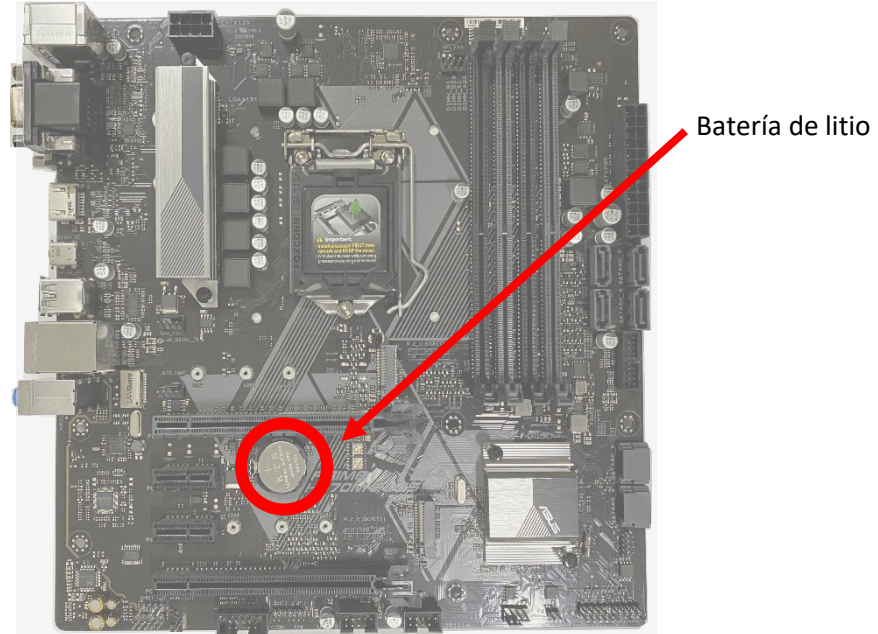
12. Extracción del ventilador del chasis: Destornillar los 4 tornillos externos y extraerlo manualmente hacia el exterior.



Información adicional

Extracción de la batería de litio del procesador

1. Colocar la placa madre en posición horizontal sobre una superficie plana con la batería de litio hacia arriba como indica la figura



2. Presionar la pestaña ubicada en el socket de la batería. Puede utilizar la espátula para facilitar el proceso, o bien, puede utilizar la mano.

